

北京耐威科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议的相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司以下事项发表事前认可意见如下：

一、关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的事前认可意见

1、关联担保情况：因公司全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）发展需要，其拟向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币 7 亿元的委托贷款，亦庄国投将委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）对上述贷款进行放款，用于 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目的建设。

公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为瑞通芯源申请的上述委托贷款提供连带责任担保，最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准，瑞通芯源免于支付担保费用。

杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定本次交易构成关联交易。

2、杨云春先生本次为瑞通芯源向亦庄国投申请委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对瑞通芯源的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

我们对控股股东为瑞通芯源申请委托贷款事项提供关联担保的相关内容表示认可，我们同意将《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。

二、关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事前认可意见

1、关联担保情况：因经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“光大银行”）申请不超过1亿元的综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。

公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

2、杨云春先生本次为公司向光大银行申请不超过1亿元的综合授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

我们对控股股东为公司向光大银行申请综合授信额度提供关联担保的相关内容表示认可，我们同意将《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

杜杰：_____

丛培国：_____

景贵飞：_____

2017 年 9 月 22 日